

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2011/RS(G)/779/9

New Delhi, dated : 1.2.2017


The General Manager, All Indian Railways/Pus, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS
MD/All Railway PSUs, KRCL, MRVC

Sub: Value addition criterion for Preference to domestically manufactured telecom products in Government procurement with respect to Telecom Products notified under the Preferential Market Access (PMA) policy dated 5th October 2012.

Ref: Ministry of Communication (Investment Promotion Cell)'s O.M. No. 18-07/2010-IP dated 17.01.2017.

Please find enclosed herewith Ministry of Communication (Investment Promotion Cell)'s above referred Office Memorandum on the above subject for necessary action.


DA: As above


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores (G)-I
Railway Board

No. 2011/RS(G)/779/9

New Delhi, date : 1.2.2017

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways
5. COSs, PCEs, CMEs, CEEs, CSTE, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS. COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
6. The Directors: -
 - (a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - (b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg. Jamalpur
 - (c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - (d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - (e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - (f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
7. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
8. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
9. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
10. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur
11. GM, CRIS for making necessary modification in www.ireps.gov.in if required.


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores (G)-I
Railway Board

No. 2011/RS(G)/779/9

New Delhi, dated : 1.2.2017

Copy to:

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhawan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room NO. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhawan.

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores (G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs/PPS/PS to:

1. MR, MOS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG (S&T), DG (Personnel), DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

No. 18-07/2010-IP
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
Investment Promotion Cell

Sanchar Bhawan, 20 Asoka Road,
New Delhi-110001,
Dated 17th January, 2017

Chairman, Railway Board
FTS No. P.250001
Date 17/1
Subject:

Office Memorandum

Value addition criterion for Preference to domestically manufactured telecom products in Government procurement with respect to Telecom Products notified under the Preferential Market Access (PMA) policy dated 5th October 2012.

The undersigned is directed to forward herewith a copy of the notification dated 11.01.2017 (which notified in the Gazette of India on 12.01.2017) issued by this Department on the above subject. It is requested to bring the same in the notice of all concerned.

Encl: As above.

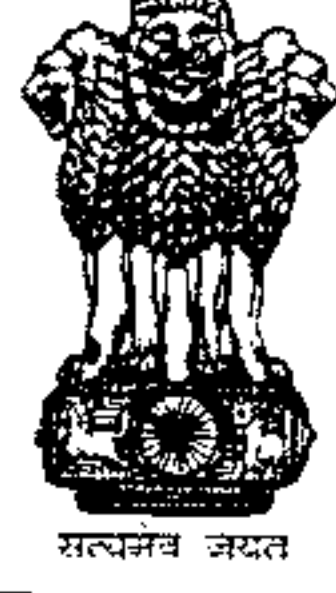


(Rahul Dwivedi)

Under Secretary to Govt. of India
Tele: 2371 3715

To,

All Ministries/ Departments of Government of India.
Cabinet Secretariat / PMO / NITI Aayog / Comptroller & Auditor General of India.
PS to Hon'ble Minister of Communications.
PPS to Secretary(Telecom)/Additional Secretary(T)/Administrator, USOF.
PPS to Member(T)/Member(S)/Member(F)/Advisor(T)/Advisor(O).
Sr. DDG, TEC, Khurshid Lal Bhawan, New Delhi.
JS(A)/CVO/All DDsG.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938

No. 11]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

विषय: दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 को प्राथमिकता बाजार अभिगम (पीएमए) नीति के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार उत्पादों के सरकारी प्रापण में देश में विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को अधिमानता देने के लिए मूल्य संवर्धन मानदंड।

- पढ़ें: 1. दूरसंचार विभाग की दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 18-07/2010-आई.पी.
2. इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की दिनांक 23 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना सं. 33(3)/2013-आई.पी.एच.डब्ल्यू
3. इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की दिनांक 16 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 33(7)/2015-आई.पी.एच.डब्ल्यू

सं. 18-07/2010-आई.पी.—दिनांक 23 दिसंबर, 2013 (पढ़ें: 2) की नीति के खंड 8 में यह उल्लेख किया गया है कि इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देशी/घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना का प्रावधान किया जाएगा। इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (पढ़ें: 3) की अधिसूचना सं. 33(7)/2015-आई.पी.एच.डब्ल्यू द्वारा पीएमए नीति को क्रियार्थक बनाने/कार्यान्वित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

2. दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (पढ़ें: 3) के दिशा-निर्देशों के खंड 4.1 के अनुसार घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना के लिए सामग्री के विल (वीओएम) में दूरसंचार उत्पादों के लिए मुख्य इन्पुट/स्तरों का उल्लेख सारणी -क में दिया गया है।

सारणी-क	
बीओएम में मुख्य इनपुट/दूरसंचार उत्पादों* के विनिर्माण के लिए स्तर	घरेलू बीओएम के रूप वर्गीकृत करने हेतु इनपुट्स की स्थितियां/शर्तें
1) डिजाइन (क) हार्डवेयर डिजाइन (ख) साफ्टवेयर डिजाइन एवं विकास	23 दूरसंचार उत्पादों के डिजाइन के लिए किसी विनिर्माता द्वारा दावा किए जा सकने योग्य अधिकतम मूल्य संवर्धन (वीए), प्रतिशत, सारणी-ख के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं कि: (क) हार्डवेयर डिजाइन के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) भारत में रहेगा; (ख) साफ्टवेयर डिजाइन और विकास के लिए कॉपीराइट भारत में होगा।
2) संघटक (कम्पोनेंट्स) (क) इंटीग्रेटेड चिपें (आईसी)- प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि (ख) एक्टिव कम्पोनेंट्स - ट्रांजिस्टर्स डियोडिज आदि (ग) पैसिव कम्पोनेंट्स - रेसिस्टर्स कैपसिटिर्स, इन्डक्टरस आदि	यदि घरेलू रूप से विनिर्मित है।
3) पीसीवी (क) पीसीवी फेब्रिकेशन (ख) पीसीवी पोपुलेशन यूनिंग कम्पोनेंट्स	यदि घरेलू रूप से विनिर्मित है।
4) केबल्स/चेमिस इत्यादि (क) चेमिस (ख) केबल्स (ग) रैक्स (घ) हीट सिक्स (ङ) एनक्लोजर्स	यदि घरेलू रूप से विनिर्मित है।
5) आर.एफ. कम्पोनेंट्स /सबसिस्टम (क) डुप्लेक्सर्स/फिल्टर्स (ख) एंटीना	यदि घरेलू रूप से विनिर्मित है।
6) एसेम्बली/इंटीग्रेशन/टेस्टिंग #	सारणी-ख में सूचीबद्ध दूरसंचार उत्पादों के संबंध में एसेम्बली/इंटीग्रेशन/टेस्टिंग के घरेलू मूल्य संवर्धन की अधिकतम सीमा कुल बीओएम उत्पादों का 10 प्रतिशत होगी (क्र.सं. 23 को छोड़कर)
7) कोई अन्य इनपुट (अदा किए गए कर एवं ड्यूटी, डोमेस्टिक सपोर्ट, मरम्मत और उन्नयन क्षमता, वारंटी लागत माल भाड़ा, रायल्टी आदि)	लागू नियमों/प्रभावी करों के अनुसार।
* उत्पाद में सारणी-क में यथा उल्लिखित कुछ/सभी इनपुट/स्तर शामिल हैं। प्रापण एजेंसी को केवल उन्हीं इनपुट/स्तरों को शामिल करना है जो इन दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण में शामिल हैं।	

यदि किसी उप पद्धति की पद्धति में केवल एकत्रण/संघटन/परीक्षण ही किया जाता है तो पद्धति/उप पद्धति की अधिकतम 10 प्रतिशत लागत की शर्त के अध्याधीन वास्तविक मूल्य संवर्धन को घरेलू वीओएम के रूप में माना जाएगा।

सारणी-ख

क्र.सं.	दूरसंचार उपकरणों का ब्यौरा	डिजाइन मूल्य संवर्धन की अधिकतम सीमा प्रतिशत में
1	एनक्रिप्शन/यूटीएम प्लेटफार्म (टीडीएम और आईपी)	60
2	कोर/एज/एंटरप्राइज रूटर्स	60
3	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क उपस्कर	35
4	इथरनेट स्विचिज (एल 2 और एल 3) हब्स, आदि	45
5	आईपीआधारित सॉफ्ट स्विचिज, मीडिया गेटवे	60
6	वायरलेस/वायरलाइन पीएवीएक्स	45
7	सीपीई (वाई-फाई अभिगम बिंदुओं और रूटर्स, मीडिया कन्वर्टर सहित), 2जी/3जी मोडम, लीज्ड लाइन मोडम, आदि	35
8	सेट-टॉप बॉक्स	35
9	एसडीएच/कैरियर-इथरनेट/पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपस्कर	35
10	डीडब्ल्यूडीएम/मीडब्ल्यूडीएम प्रणालियां	35
11	जीपीओएन उपस्कर	35
12	डिजिटल क्रॉस कनेक्टम/एमयूएक्स	35
13	छोटे आकार के 2जी/3जी जीएसएम आधारित बेस स्टेशन प्रणालियां	45
14	एलटीई आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सएम प्रणालियां (ई नोड बी, ईपीसी, आदि)	45
15	वाई-फाई आधारित ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम प्रणालियां (अभिगम बिंदु, एग्रीगेशन ब्लॉक, कोर ब्लॉक आदि)	35
16	माइक्रोवेव रेडियो प्रणालियां (आईपी/हाईब्रिड)	35
17	साफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो, कार्नीटिव रेडियो प्रणालियां	45
18	रिपीटर्स (आरएफ/ आरएफ-ओवर-ऑप्टिकल), आईवीएम और मंत्रितरित एंटेना प्रणाली	35
19	उपग्रह आधारित प्रणालियां -हब्स, वीमेट आदि	35
20	कॉपर अभिगम प्रणालियां (डीएसएस/डीएसएसएस)	35
21	नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां	60
22	सुरक्षा एवं निगरानी संचार प्रणालियां (वीडियो एवं सेंसर आधारित)	45
23	ऑप्टिकल फाइबर केबल	शून्य

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2017

Subject: Value addition criterion for Preference to domestically manufactured telecom products in Government procurement with respect to Telecom Products notified under the Preferential Market Access (PMA) policy dated 5th October 2012.

- Read:** 1. DoT's Notification no. 18-07/2010-IP dated 5th October 2012
2. DeitY's Notification no. 33(3)/2013-IPHW dated 23rd December 2013
3. DeitY's Notification no. 33(7)/2015-IPHW dated 16th November 2015

No. 18-07/2010-IP.—Clause 8 of the Policy dated 23rd December 2013 (Read 2) states that detailed guidelines shall be issued for operationalizing the policy which would, inter-alia, provide for calculation of domestic value addition. Department of Electronics and Information Technology, vide Notification No. 33(7)/2015-IPHW dated 16th November 2015 (Read 3), has also issued the guidelines for the operationalization/implementation of PMA policy.

2. In terms of clause 4.1 of the guidelines of dated 16th November 2015 (Read 3), the main inputs/stages for the telecom products in the Bill of Materials (BOM) for calculating domestic value addition are mentioned in Table A.

TABLE-A

Main Inputs in BOM/stages for manufacture of telecom products *	Conditions for the inputs to be classified as Domestic BOM
(1) Design (a) Hardware design (b) Software Design & Development	The maximum Value Addition (VA) percentage for Design which can be claimed by a domestic manufacturer for the 23 telecom products are as per Table-B subject to the condition that: (a) The Intellectual Property Right (IPR) resides in India for Hardware Design. (b) The Copyright is in India for the software Design & Development.
(2) Components (a) Integrated chips (ICs) – Processor, Memory etc. (b) Active components - Transistors, Diodes etc. (c) Passive Components – Resistors, Capacitors, Inductors etc.	If manufactured domestically
(3) PCBs (a) PCB Fabrication (b) PCB population using components	If manufactured domestically
(4) Cables/Chassis etc. (a) Chassis (b) Cables (c) Racks (d) Heat sinks (e) Enclosures	If manufactured domestically
5) RF Components/Subsystem (a) Duplexers/Filters (b) Antenna	If manufactured domestically
(6) Assembly/Integration/Testing ⁷	The upper ceiling limit of Domestic Value Addition (VA) for Assembly/ Integration

	Testing in respect of the telecom products listed in Table B would be 10% of the total product BOM (except S. No. 23).
(7) Any Other Input (Taxes and Duties paid, domestic Support, Repair and upgrade capability, Warranty Cost Freight Insurance and other handling costs royalty etc.)	As per applicable rules/taxes in force.
* The product may include some/all of the input/stage as mentioned in table A. The procurement agency shall include only those inputs/stages which are involved in the manufacturing of these telecom products.	
# In case a system or its subsystem is merely assembled / integrated / tested, then actual value addition subject to a maximum of 10% of the cost of system / subsystem shall be taken as domestic BOM.	

TABLE-B

Sl. No.	Telecom equipment Description	Maximum ceiling of Design value addition in %
1	Encryption/UTM platforms (TDM and IP)	60
2	Core/Edge/Enterprise routers	60
3	Managed Leased line Network equipment	35
4	Ethernet Switches (L2 and L3), Hubs, etc.	45
5	IP based Soft Switches, Media gateways	60
6	Wireless/Wireline PABXs	45
7	CPE (including WiFi Access points and Routers, Media Converters), 2G/3G Modems, Leased-line Modems, etc.	35
8	Set-Top Boxes	35
9	SDH/Carrier-Ethernet/Packet Optical Transport equipments	35
10	DWDM/CWDM systems	35
11	GPON equipments	35
12	Digital Cross Connects/ MUX	35
13	Small size 2G/3G GSM based Base Station Systems	45
14	LTE based broadband wireless access systems (eNodeB, EPC, etc.)	45
15	Wi-Fi based broadband wireless access systems (Access Point, Aggregation Block, Core Block, etc.)	35
16	Microwave Radio systems (IP/Hybrid)	35
17	Software Defined Radio, Cognitive Radio systems	45
18	Repeaters (RF/RF-over-Optical), IBS, and Distributed Antenna system	35
19	Satellite based systems -Hubs, VSAT etc.	35
20	Copper access systems (DSL/DSLAM)	35
21	Network Management systems	60
22	Security and surveillance communication systems (video and sensors based)	45
23	Optical Fiber Cable	NIL

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.